上海硅产业集团股份有限公司

公司代码:688126　　公司简称:沪硅产业

2026半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	沪硅产业	688126	不适用

公司存托凭证简况

□适用√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	方娜	王艳
电话	021-52589038	021-52589038
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号
电子信箱	pr@sh-nsig.com	pr@sh-nsig.com

2.2主要财务数据

单位:万元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,821,163.23	3,378,655.79	13.10
归属于上市公司股东的净资产	1,938,970.73	1,692,484.08	14.56
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	231,724.48	169,743.27	36.51
利润总额	-101,570.98	-53,311.43	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-96,515.19	-36,653.82	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95,763.26	-48,103.43	不适用
经营活动产生的现金流量净额	17,898.75	-46,184.96	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.63	-3.05	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.292	-0.133	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.292	-0.133	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	11.17	9.16	增加2.01个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	166,307
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
上海国盛(集团)有限公司	国有法人	16.58	548,000,000	0	0	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	12.49	412,905,757	0	0	无	0
华芯投资管理有限责任公司—国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	其他	9.05	298,994,701	226,983,180	226,983,180	无	0
上海嘉定工业区开发(集团)有限公司	国有法人	3.75	123,975,596	0	0	无	0
海富产业投资基金管理有限公司—海富半导体创业投资(嘉兴)合伙企业(有限合伙)	其他	3.16	104,489,404	104,489,404	104,489,404	无	0
上海新阳半导体材料股份有限公司	境内非国有法人	2.92	96,444,772	0	0	无	0
上海新微科技集团有限公司	国有法人	1.59	52,460,780	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.55	51,250,694	0	0	无	0
中建材(安徽)新材料产业投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.41	46,623,551	46,623,551	46,623,551	无	0
长江证券股份有限公司—华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02	33,709,571	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	/						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用□不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
上海硅产业集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	23沪硅K1	240187	2023-11-17	2028-11-17	13.4	3.17
上海硅产业集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24沪硅产业MTN001	102484726	2024-10-29	2029-10-31	5	0.0268
上海硅产业集团股份有限公司2025年度第一期中期票据(科创票据)	25沪硅产业MTN001(科创票据)	102581788	2025-04-21	2030-04-23	10	0.0240
上海硅产业集团股份有限公司2026年度第一期科技创新债券	26沪硅产业MTN001(科创债)	102680747	2026-03-09	2031-03-11	12	0.0211

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	37.57	40.33
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.82	1.57

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年09月11日(星期五)14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年09月04日(星期五)至09月10日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱pr@sh-nsig.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:业务部

电话:021-52589038

邮箱:pr@sh-nsig.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司

2026年8月20日

证券代码:688126　证券简称:沪硅产业　公告编号:2026-041

上海硅产业集团股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

1.2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3930号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)240,038,399股,每股面值人民币1元,募集资金总额为4,999,999,851.17元,扣除各项发行费用53,814,364.71元(不含增值税),实际募集资金净额为4,946,185,486.46元。上述募集资金于2022年2月17日到位,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了普华永道中天验字(2022)第0162号验资报告。

2021年度向特定对象发行A股股票募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2022年2月17日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	499,999.99
其中:超募资金金额	0
减:直接支付发行费用	5,381.44
二、募集资金净额	494,618.55
减:	
以前年度已使用金额	382,661.00
本年度使用金额	17,133.00
暂时补流金额	0
现金管理金额	100,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	55.94
加:	
募集资金利息收入	17,097.18
三、报告期期末募集资金余额	11,865.79

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所造成。

2.2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]2140号文《关于同意上海硅产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》,公司本次募集配套资金发行股份110,440,713股,每股面值人民币1元,募集资金总额为2,104,999,989.78元,扣除各项发行费用26,289,537.46元(不含增值税),实际募集资金净额为2,078,710,452.32元。上述募集资金于2025年12月17日到位,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2025]第ZA15263号验资报告。

截至2025年12月17日,公司向特定对象发行股票募集资金总额人民币2,104,999,989.78元,扣除中国国际金融股份有限公司承销费及财务顾问费合计人民币13,447,500.00元(含增值税),实际收到募集资金2,091,552,489.78元,此款项已于2025年12月17日汇入本公司开立的募集资金专项账户中。

2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间	2025年12月17日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	210,500.00
其中:超募资金金额	0
减:直接支付中介费用	1,344.75
二、实际收到的募集资金	209,155.25
减:	
以前年度已使用金额	33,369.80
本年度使用金额	15,093.48
暂时补流金额	0
现金管理金额	130,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0
加:	
募集资金利息收入	238.60
三、报告期期末募集资金余额	30,930.57

注:上述表格数据如有尾差,系四舍五入所造成。

二、募集资金管理情况

公司已按照相关法律法规的要求制定《上海硅产业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《募集资金使用管理制度》”),对募集资金实行专户存储制度、对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该办法已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。2023年11月17日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案。2024年6月14日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于修订部分内部治理制度的议案》,包括子议案关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。2025年8月15日,公司召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于修订部分内部治理制度的议案》,包括子议案关于修订《募集资金使用管理制度》的议案。

根据上海证券交易所及有关规定的要求,于2022年2月,公司及保荐人分别与平安银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022年5月,公司及保荐人与上海新昇半导体科技有限公司(以下简称“上海新昇”)并招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022年6月,公司及保荐人与上海新傲科技股份有限公司(以下简称“新傲科技”)并上海银行股份有限公司市北分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022年7月,公司及保荐人与上海新昇、上海晶昇新诚半导体科技有限公司(以下简称“晶昇新诚”;后更名为“上海新昇晶投半导体科技有限公司”,以下简称“新昇晶投”)、上海新昇晶科半导体科技有限公司(以下简称“新昇晶科”)并招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。于2024年5月,公司及保荐人与新傲科技、上海新傲芯翼科技有限公司(以下简称“新傲芯翼”)并上海银行股份有限公司市北分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。于2025年12月,公司及独立财务顾问与招商银行股份有限公司上海华灵支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,且得到了切实履行。

2021年度向特定对象发行A股股票募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年度向特定对象发行A股股票			
募集资金到账时间	2022年2月17日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海硅产业集团股份有限公司	上海银行嘉定支行	03004841882	9,752.41	使用中
上海新傲科技股份有限公司	上海银行嘉定支行	03004911414	941.93	使用中
上海新傲芯翼科技有限公司	上海银行嘉定支行	03005771225	1,171.45	使用中
上海硅产业集团股份有限公司	平安银行上海南京西路支行	15981666888880	/	已注销
上海硅产业集团股份有限公司	中国银行上海张江高科技园区支行	457282551286	/	已注销
上海新昇半导体科技有限公司	招商银行上海华灵支行	121921770510806	/	已注销
上海新昇晶投半导体科技有限公司	招商银行上海华灵支行	121945833410718	/	已注销
上海新昇晶科半导体科技有限公司	招商银行上海华灵支行	121945865110918	/	已注销

2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金			
募集资金到账时间	2025年12月17日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海硅产业集团股份有限公司	招商银行上海华灵支行	121918983010028	30,930.57	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

1.2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

公司2026年半年度募集资金投资项目的资金使用情况参见“附表1:2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表”。

2.2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

公司2026年半年度募集资金投资项目的资金使用情况参见“附表2:2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1.2021年度向特定对象发行A股股票募集资金

为顺利推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目,截至2022年5月27日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币14,941.99万元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述自筹资金预先投入的使用情况出具了《上海硅产业集团股份有限公司截至2022年5月27日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2022)第4117号)。

2022年6月24日,公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先投入的自筹资金的议案》,公司独立董事发表了明确的同意意见。保荐人于2022年6月24日出具了《海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》(海通证券股份有限公司现用名:国泰海通证券股份有限公司,下文同)。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等有关规定,公司使用募集资金14,941.99万元置换了预先已投入的自筹资金。公司已将14,941.99万元募集资金转至公司自有资金银行账户,完成了募集资金投资项目预先投入的置换工作。

募集资金置换先期投入表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年度向特定对象发行A股股票				
募集资金到账时间	2022年2月17日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
300mm高端硅基材料研发中试项目	214,420.80	14,941.99	14,941.99	2022年6月27日	2022年6月24日

2023年4月10日,公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》,同意项目的原实施主体上海新昇使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项后,再由项目的现实施主体新昇晶科使用募集资金对上述款项做等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了明确的同意意见,保荐人海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

2.2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至2026年6月30日,2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚未以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司为提高募集资金使用效率,将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资产品的期限不超过12个月。

2025年4月22日,公司第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过160,000万元(包含本数)部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。监事会发表了明确同意的独立意见。保荐人出具了《国泰海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2026年4月15日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下,拟使用额度不超过250,000万元(包含本数)部分暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在不超过上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。其中2021年度向特定对象发行A股股票的暂时闲置募集资金拟使用额度不超过100,000万元(包含本数),2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的暂时闲置募集资金拟使用额度不超过150,000万元(包含本数)。保荐人出具了《国泰海通证券股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,独立财务顾问出具了《中国国际金融股份有限公司关于上海硅产业集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年度向特定对象发行A股股票			
募集资金到账时间	2022年2月17日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
160,000	用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款等	2025年4月22日	2026年4月22日	2025年4月22日
100,000	用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款等	2026年4月15日	2027年4月15日	2026年4月15日

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年度向特定对象发行A股股票						
募集资金到账时间	2022年2月17日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	年化收益率	利息金额
上海硅产业集团股份有限公司	上海银行嘉定支行	单位定期存款	定期存款	120,000.00	2025-10-28	2026-1-28	1.20%	360.00
上海硅产业集团股份有限公司	上海银行嘉定支行	单位大额第三千二百零七M01S	大额存单	100,000.00	2026-1-30	2026-2-28	1.30%	108.33
上海硅产业集团股份有限公司	上海银行嘉定支行	单位大额第三千二百九十九M01S	大额存单	100,000.00	2026-3-3	2026-4-3	1.30%	108.33
上海硅产业集团股份有限公司	上海银行嘉定支行	上海银行“稳进”3号第SDG22601M161B期结构性存款产品SDG22601M161B	结构性存款	100,000.00	2026-4-28	2026-6-1	1.50%	139.73
上海硅产业集团股份有限公司	上海银行嘉定支行	单位大额第三千六百九十五M01S	大额存单	100,000.00	2026-6-2	2026-7-2	1.30%	未到期

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金			
募集资金到账时间	2025年12月17日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
150,000	用于投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月(含)、发行主体为有保本承诺的金融机构的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款、通知存款等	2026年4月15日	2027年4月15日	2026年4月15日

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金						
募集资金到账时间	2025年12月17日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	年化收益率	利息金额
上海硅产业集团股份有限公司	招商银行上海华灵支行	单位通知存款	7天通知存款	140,000.00	2026-4-29	2026-5-6	0.75%	20.42
上海硅产业集团股份有限公司	招商银行上海华灵支行	招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款(产品代码:NSH09788)	结构性存款	140,000.00	2026-5-7	2026-6-8	1.50%	184.11
上海硅产业集团股份有限公司	招商银行上海华灵支行	招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代码:NSH09954)	结构性存款	130,000.00	2026-6-10	2026-7-10	1.45%	未到期

2026年半年度,公司累计使用募集资金进行现金管理发生额为810,000万元,累计收回募集资金进行现金管理发生额为700,000万元,实现收益920.92万元。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

2024年5月24日,公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金向控股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的议案》,同意控股子公司新傲科技使用募集资金不超过人民币7.65亿元向其控股子公司新傲芯翼实缴注册资本,并自决议通过之日起以募集资金合计向新傲科技、新傲芯翼提供不超过人民币12亿元借款,以专项实施募投项目“300mm高端硅基材料研发中试项目”。监事会发表了明确的同意意见,保荐人海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

2025年8月28日,公司召开第三届董事会第二次会议、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,同意公司将募投项目“300mm高端硅基材料研发中试项目”的建设期延长至2026年12月。本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定,未改变募集资金的投资方向、投资总额和项目建设内容,不会对募投项目的实施产生实质性的影响。保荐人国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

2026年6月9日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有资金、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司“300mm高端硅基材料研发中试项目”的实施主体新傲科技及新傲芯翼在项目实施期间,先行使用自有资金、信用证等方式支付募集资金投资项目部分款项,再使用募集资金对上述款项做等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、变更及增加募投项目实施主体的情况

2022年5月25日,公司召开第一届董事会第四十三次会议、第一届监事会第二十五次会议,并于2022年6月10日召开公司2022年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》,募投项目“集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目”原实施主体上海新昇以募集资金15亿元投资并控股晶昇新诚(后更名为“新昇晶投”),再由晶昇新诚(后更名为“新昇晶投”)以募集资金15亿元出资参与设立二级控股子公司新昇晶科,并由新昇晶科作为募投项目最终实施主体。由于上述募投项目实施主体变更事项,新昇晶投、新昇晶科分别在招商银行股份有限公司上海华灵支行开设账户作为募集资金专项账户。

2024年4月11日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》,同意公司增加控股子公司新傲芯翼为募投项目“300mm高端硅基材料研发中试项目”的实施主体,项目实施地点仍为上海。由于上述增加募投项目实施主体的事项,新傲芯翼在上海银行股份有限公司市北分行开设账户作为募集资金专项账户。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年8月20日

附表1:2021年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2021年度向特定对象发行A股股票														
募集资金到账日期	2022年2月17日														
本年度投入募集资金总额	17,133.00														
已累计投入募集资金总额	399,794.00														
变更用途的募集资金总额	0														
变更用途的募集资金总额比例	/														
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	是否已变更项目(含部分变更,如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期投入进度(%)=(4)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目	生产建设	无	150,000	150,000	150,000		154,417.55	4,417.55	102.95	不适用	不适用	不适用	否		
300mm高端硅基材料研发中试项目	生产建设	无	200,000	200,000	200,000	17,133.00	100,650.53	-99,349.47	50.33	不适用	不适用	不适用	否		
补充流动性资金	补流	无	150,000	144,618.55	144,618.55		144,725.92	107.37	100.07	不适用	不适用	不适用	否		
合计			500,000	494,618.55	494,618.55	17,133.00	399,794.00	-94,824.55	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	2025年8月28日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意募投项目“300mm高端硅基材料研发中试项目”的建设期延长至2026年12月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。														
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”。														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。														
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。														
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。														
募集资金结余的金额及形成原因	“集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目”结余金额632.05万元,“补充流动性资金”结余金额107.37万元,均系利息收入。300mm高端硅基材料研发中试项目尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。本报告期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。														
募集资金其他使用情况	详见“三、(八)募集资金使用的其他情况”及“五、变更及增加募投项目实施主体的情况”。														

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:募投项目性质包括:“生产建设”、“研发项目”、“运营管理”、“投资并购”、“补流”、“还贷”、“回购公司股份”、“其他”;“其他”类型,应当注释说明。

附表2:2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2025年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金														
募集资金到账日期	2025年12月17日														
本年度投入募集资金总额	15,093.48														
已累计投入募集资金总额	49,808.03														
变更用途的募集资金总额	0														
变更用途的募集资金总额比例	/														
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	是否已变更项目(含部分变更,如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截期投进(%)=(4)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
补充流动资金	补流	无	175,000	175,000	175,000	14,916.48	14,916.48	-160,083.52	8.52	不适用	不适用	不适用	否		
支付本次交易的现金对价及中介机构费用	其他一支付现金对价及中介费用	无	35,500	35,500	35,500	177.00	34,891.55	-608.45	98.29	不适用	不适用	不适用	否		
合计			210,500	210,500	210,500	15,093.48	49,808.03	-160,691.97	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用。														
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。														
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”。														
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。														
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。														
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本报告期不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。														
募集资金结余的金额及形成原因	本报告期募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。														
募集资金其他使用情况	详见“三、(八)募集资金使用的其他情况”。														

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:募投项目性质包括:“生产建设”、“研发项目”、“运营管理”、“投资并购”、“补流”、“还贷”、“回购公司股份”、“其他”;“其他”类型,应当注释说明。

证券代码:688126　证券简称:沪硅产业　公告编号:2026-042

上海硅产业集团股份有限公司关于2026年上半年计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况及经营成果,经公司及下属子公司对各项金融资产、存货、预付款项和长期资产等进行全面充分的评估和分析,认